



# 21 年上半年半导体中报回顾： 半导体景气度高企 国产龙头 公司业绩超预期



事项：21 年半导体中报总结

1、全球缺芯叠加国产化趋势，国内半导体整体景气度较好，半导体产业链 21 年上半年表现出色。

根据 SIA 数据显示，2021 年上半年全球半导体销售额 2506 亿美元，同比增长 20%，增速为 2019 年以来新高。部分全球半导体龙头企业 B/B（订单出货比值）远高于标准值 1，例如英飞凌最新其 FQ3 财报 B/B 至为 2.4 倍（FQ2 为 2.1）显示景气度较高。国内半导体景气度较好，半导体板块季度盈利持续提升，2021 年 2 季度 SW 半导体扣非季度 ROE 为 2.79%，创历史新高，半导体板块营收 828 亿，环比增长 19%，净利润 163 亿，环比增长 106%，营收及利润均创历史新高。

2、截止 2021/09/2，半导体 TTM 估值呈现回落，为近 1 年来低位。

截止 2021/9/2，SW 半导体 TTM 估值中位数为 85 倍，估值分位数近 1 年、3 年、5 年分别为 25%、46%、57%，主要系半导体公司 21 年上半年业绩增长较好，且近期半导体板块有所回落。其中半导体设备龙头（北方华创、中微公司等）估值最高约为 163~194 倍，半导体封测龙头（长电科技、通富微电等）估值最低约为 24~32 倍。

2021 年上半年，SW 半导体市场涨幅前 5 名：1、明微电子涨幅 419%，2、富满电子涨幅 295%，3、全志科技涨幅 174%，4、中颖电子涨幅 162%，5、国科微涨幅 159%。2021 年上半年，SW 半导体市场跌幅前 5 名：1、

澜起科技下跌 24%，2、ST 大唐下跌 21%，3、派瑞股份下跌 18%，4、聚辰股份下跌 18%，5、汇顶科技下跌 16%。

3、细分行业板块，半导体设备营收增速最快，晶圆制造利润增速最快。晶圆制造产能紧缺，全球晶圆厂扩产加速，拉动上游设备及材料增长。全球晶圆厂扩产加速，根据全球晶圆制造龙头台积电 21 年中报显示，其 21 年资本开支计划为 300 亿美元（2020 年为 170 亿美元，月产量增长 14.1 万片 12 英寸），预计未来三年内总投入 1000 亿美元以增加产能。9 月 2 日，中国晶圆制造龙头中芯国际，宣布计划合资于上海临港新建晶圆厂，规划月产能约 10 万片（12 英寸），结合前期中芯京城项目及中芯深圳项目总计规划新增约 24 万片/月（12 英寸）产能，相当于公司截至 1H21 总产能的 96.2%（折合 8 英寸）。

上游设备：半导体设备端替代显现加速。半导体设备板块 1H21 营收 77 亿，同比增长 66%，净利润 104 亿，同比增长 115%，毛利率 44%，同比增长 5.2pct，净利率 17%，同比增长 4.8pct，期末存货 116 亿，同比增长 59%，存货周转天数 487 天，同比增长 5%，经营性净现金流-5 亿，同比由正转负。

在半导体产能紧缺以及国产替代背景下，以北方华创、中微公司为代表龙头设备公司，21Q2 显现较好的成长。其中设备龙头的北方华创 2Q21 营收同比增长 76%，净利润同比增长 59%；中微公司 2Q21 营收同比增长 30%，净利润同比增长 179%。

上游材料：半导体材料稳步增长。半导体材料认证周期相对较长，且相对而言滞后与设备端，营收呈现稳步增长。

半导体材料板块 1H21 营收 142 亿，同比增长 53%，净利润 10 亿，同比增长 120%，毛利率 15%，同比增长-0.6pct，半导体材料净利率 7%，同比增长 2.2pct，期末存货 45 亿，同比增长 29%，存货周转天数 67 天，同比下降 17%，经营性净现金流 2 亿，同比由负转正。

2Q21 半导体耗材龙头，沪硅产业（大硅片）总营收同比增长 35%，净利润同比扭亏为盈；安集科技（抛光液）总营收同比增长 72%，净利润同比 167%；鼎龙股份（抛光垫）总营收增长 9%，净利润同比下降 69%。

中游：晶圆代工产能利用率较高，盈利能力大幅提升。21 年 2 季度，中游制造产能紧缺持续，全球各大晶圆代工厂有 10%~15%涨价，盈利能力显现较好提升。晶圆代工板块 1H21 营收 205 亿，同比增长 27%，净利润 62 亿，同比增长 272%，毛利率 28%，同比增长 4.0pct，净利率 30%，同比增长 19.8pct，期末存货 75 亿，同比增长 27%，存货周转天数 92 天，同比增长 6%，经营性净现金流 116 亿，同比增长 222%。

中芯国际二季度产能利用率超过 100%，并且 ASP 提升，带动 2Q21 营收同比增长 30%，净利润同比增长 403%。

中游：半导体封测端同样景气度较高。封测产能供不应求。且受疫情影响海外（如马来西亚）部分封测厂停产，进一步加剧了封测产能紧张。

半导体封测板块 1H21 营收 277 亿，同比增长 31%，净利润 29 亿，同比增长 188%，毛利率 20%，同比增长 3.4pct，净利率 10%，同比增长 5.7pct，期末存货 64 亿，同比增长 15%，存货周转天数 52 天，同比下降 9%，经营性净现金流 70 亿，同比增长 89%。

封测龙头 2Q21 长电科技营收同比增长 13%，净利润同比增长 302%，通富微电营收增长 53%，净利润同比增长 77%。

下游：半导体芯片设计，同比增速较好。2 季度芯片设计公司中，主要系下游芯片缺货，以及 AIOT 及国产设计芯片替代趋势显著，整体营收增速较好。半导体设计 1H21 营收 587 亿，同比增长 52%，净利润 104 亿，同比增长 115%，毛利率 39%，同比增长 0.2pct，净利率 18%，同比增长 5.2pct，期末存货 235 亿，同比增长 17%，存货周转天数 119 天，同比下降 23%，经营性净现金流 58 亿，同比由负转正。

2Q21 各主要芯片设计龙头：CIS 芯片龙头 WEGF 营收同比增长 48%，净利润同比增长 134%；存储龙头北京君正，营收同比增长 326%，净利润同比扭亏为赢；射频芯片龙头卓胜微营收同比增长 115%，净利润同比

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_34911](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34911)

